

## PRESS RELEASE

新加坡，2024 年 11 月 06 日

### **NexGen Wafer Systems | 耐晶科技推出 SERENO：集成计量的多功能高产能湿法蚀刻与清洗解决方案，支持 6 英寸、8 英寸及 12 英寸晶圆**

近日，耐晶科技隆重推出最新的多腔室设备 **SERENO** - 专为湿法蚀刻与清洗应用而设计。

**SERENO** 具有卓越的性能与高度的灵活性——配备了集成计量系统，用于精确控制晶圆厚度和粗糙度；内部化学供应系统支持多种工艺化学品，并具备集成混合、配比和化学分析能力，确保在晶圆拥有广泛应用性与最佳适应性。

**SERENO** 占地仅 12 平方米，每小时可高效处理 200 片晶圆。该平台专为前端（FEOL）和后端（BEOL）应用设计，旨在满足半导体行业对更高性能、更高精度及更高成本效益的需求，是未来半导体制造的理想选择。

### **高性能与紧凑设计的完美结合**

**SERENO** 在晶圆处理和工艺控制方面具备高度灵活性，支持 6 英寸、8 英寸和 12 英寸等多种晶圆尺寸。其多功能处理系统能够高效处理从低于 100 微米的超薄晶圆到厚度超过 2 毫米的键合晶圆。高性能的工艺腔室结合创新的化学品分配和扫描控制，提供了最大的工艺自由度，确保晶圆处理的卓越表现。

耐晶科技首席营销官 Christian Kleindienst 表示：“**SERENO** 在紧凑的空间实现了高性能的晶圆湿法蚀刻与清洗，同时也充分发挥了单片晶圆技术的灵活性，不仅满足了客

户对高效单片晶圆解决方案的需求，还有效降低了企业运营成本，是替代传统批量设备的理想之选。”

## SERENO 主要特性

- **高产能：**每小时处理高达 200 片晶圆。
- **占地面积：**仅 12 平方米。
- **先进的工艺控制：**定制化晶圆扫描与精确液体分配。
- **集成计量：**内置厚度与粗糙度计量，提供实时反馈，确保工艺一致性与质量。
- **高性能腔室：**行业领先的液体流量与排气性能，确保无交叉污染。
- **多功能化学品供应：**内部储存可支持多达三种工艺化学品，配有双 90 升储罐，确保工艺连续性。
- **灵活的晶圆处理：**支持 6 英寸、8 英寸和 12 英寸晶圆，包括超薄和易脆称底，并具备多晶圆尺寸的桥接工具功能。

## SERENO 应用领域

### 表面清洗

- 颗粒去除
- 聚合物去除
- 残留物去除
- 背面/倒角清洗
- 晶圆清洗

### 薄膜与金属蚀刻

- 背面/倒角薄膜蚀刻（氮化硅 | 二氧化硅 | 多晶硅）
- 金属蚀刻（钛 | 镍 | 银 | 金 | 铝 | 钨 | 铜等）
- 底部金属层蚀刻（银 | 镍 | 钛等）

### 称底蚀刻

- 减薄
- 应力消除
- 表面调理
- Via 显露

### 支持的称底

- 硅 (Si) | 碳化硅 (SiC) | 氮化镓 (GaN) | 砷化镓 (GaAs) | 氧化铝 (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) | 氧化锌 (ZnO)

## 供货信息

SERENO 现已接受订单，首批交付将于 2025 年第一季度开始。如需了解更多信息或安排演示，请联系耐晶科技：[sereno@nexgenws.com](mailto:sereno@nexgenws.com)。

## 关于 NexGen Wafer Systems | 耐晶科技

耐晶科技总部位于新加坡，是全球领先的半导体湿法蚀刻与清洗解决方案供应商。公司在奥地利设有工程与制造设施中心，拥有一支由 100 多名专业人员组成的国际化团队，服务全球不同主半导体制造领域客户。

通过位于新加坡的研究与演示实验室，耐晶科技还为客户打造一个灵活高效的合作平台，以加快湿法蚀刻与清洗工艺的开发，从而适应行业快速变化的研发节奏。

耐晶科技已在全球范围内安装超过 200 个处理腔体，正稳步向成为专用表面处理应用领域的国际领导者迈进。

更多资讯请访问：<https://www.nexgen-wafer-systems.com/zh-hans/塞雷诺/>

更多耐晶科技的新聞資訊，請點[鏈接](#)

此新聞稿已上傳至[鏈接](#)

在 [LinkedIn](#) 追蹤耐晶動態

### 公司联系方式

Sabine Kosz

[publicrelations@nexgenws.com](mailto:publicrelations@nexgenws.com)

+43 676 840 346 400